

南亚新材料科技股份有限公司

关于公司年产 120 万平米 IC 载板材料 智能工厂建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂建设项目
- 投资金额：42,560 万元
- 相关风险提示：项目实施过程中可能面临宏观环境变化、市场竞争、技术等不确定因素影响，导致项目进程及效益不达预期的风险等。

一、项目投资概述

为顺应产业发展趋势，不断完善自身产品布局以满足客户及终端需求，同时提升公司 IC 载板领域的核心竞争力，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 42,560 万元投资建设年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂项目。

二、投资项目基本情况

- 1、项目名称：年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂建设项目
- 2、实施主体：南亚新材料科技股份有限公司
- 3、建设地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
- 4、项目投资总额及资金来源：总投资人民币 42,560 万元，其中固定资产投资 27,560 万元，铺底流动资金 15,000 万元，最终以实际投资为准。资金全部由公司自筹。
- 5、项目设计产能：该项目建成达产后，将形成年产 120 万平米 IC 载板材料

的生产能力。

6、项目建设周期：24个月，自2022年7月至2024年6月，具体以实际建设期为准。

三、相关审议程序

2022年6月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司年产120万平米IC载板材料智能工厂建设项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议通过。

四、项目投资对公司的影响

（一）符合国家产业政策，符合行业发展趋势

IC载板材料，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，目前日系、韩系企业几乎垄断整个IC载板材料市场。该项目的实施，将填补国内载板材料的研发和制造空缺，推动我国IC载板材料的发展，完善我国半导体芯片产业链。

（二）市场前景广阔

随着云计算、大数据新一代互联网技术、5G通信、AI人工智能、自动驾驶等产业和万物互联的智慧城市的发展，连续多年对IC载板的市场需求呈现高速增长。特别是我国IC载板制造技术和HDI制造能力的提高，适应了半导体产业的发展，全球市场份额也大幅提升，市场前景广阔。

（三）符合公司中长期发展目标，有利于提升公司核心竞争力

该项目是公司实现中长期发展目标的重要举措，是在公司研发技术优势的基础上对公司现有业务的扩展和延伸，有效推进IC载板材料技术及生产应用，对提升公司核心竞争力和盈利水平、实现公司发展战略目标具有重要意义，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、项目投资的风险分析

（一）宏观环境风险

如国内外市场对半导体的需求放缓而不及预期，包括中美贸易摩擦的缓和使其影响带来国内半导体产业链的自建与发展放缓，从而影响该项目中产品研发及营销计划的顺利实施。

（二）市场竞争风险

从全球竞争格局看，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的

优势，几乎垄断了整个 IC 封装材料行业的市场。若未来国外同行同类产品降价或市场需求减少，将可能导致市场竞争加剧，使得产品市场开拓不达预期的风险。

（三）技术风险

为满足不断变化的市场需求，各竞争对手都在争相开发新产品。如果已开发技术成果不能得到有效保护且技术不能根据行业发展及市场需求有效迭代发展，则公司可能面临产品技术优势降低的风险。

为此，公司将积极关注产业政策、行业发展趋势及市场变化，及时调整策略，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日